

## 会社データ 2008年(平成20年)3月31日現在

商号	株式会社フジミインコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1 TEL. 052-503-8181(代表)
設立年月日	1953年(昭和28年)3月20日
資本金	47億5,343万8,500円
代表者	代表取締役社長 関 敬史 (2008.4.1就任)
従業員	776名(個別567名)

## 株主メモ 2008年(平成20年)3月31日現在

決算期	3月31日
基準日	3月31日
単元株式数	100株
公告方法	電子公告 ( <a href="http://www.fujimiinc.co.jp">http://www.fujimiinc.co.jp</a> ) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。
株主名簿管理人	東京都中央区日本橋茅場町1-2-4 日本証券代行株式会社 本店および各支店
同事務取扱場所	名古屋市中区栄3-7-20 日土地栄町ビル 日本証券代行株式会社 名古屋支店
同取次所	日本証券代行株式会社 本店および各支店

## 株式会社フジミインコーポレーテッド

お問い合わせ先：経営企画室企画課  
TEL：052-503-8181(代表)  
URL：<http://www.fujimiinc.co.jp>

この報告書は環境保全のため、大豆油インキと再生紙を使用しております。

# FUJIMI TODAY Vol. 26

株式会社フジミインコーポレーテッド  
株主通信 平成20年6月(第56期事業報告)



→P2~6  
“特集” 新社長に聞く  
私が考える  
フジミの成長戦略

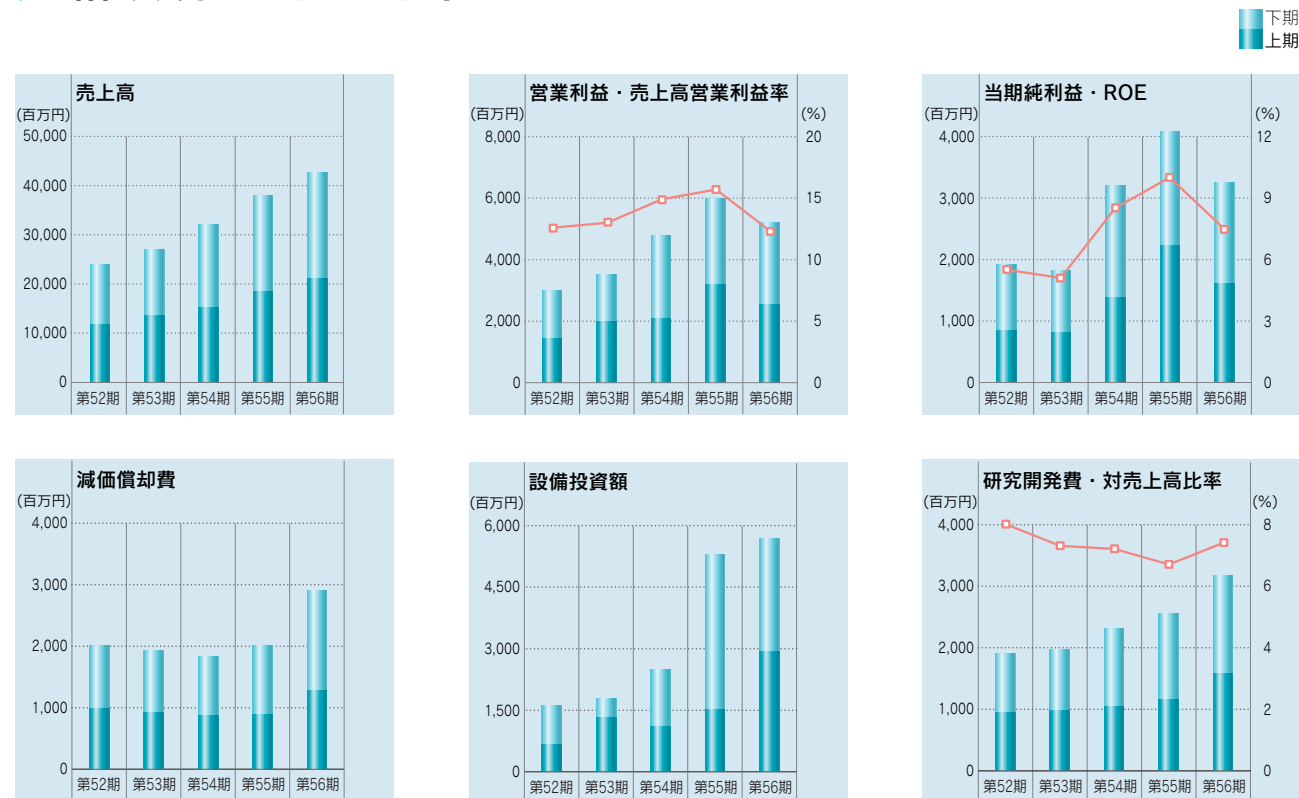
President / CEO  
Keishi Seki

Chairman  
Akira Koshiyama

FUJIMI

証券コード 5384

# 連結決算ハイライト



第56期におけるわが国経済は、世界的な原油や原材料価格の持続的な高騰による影響や米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱、為替市場の変動や株式市場の低迷など、予断を許さない状況下にありました。そうした環境下、半導体市場はデジタル家電製品などの好調な販売にも支えられ、引き続き堅調に推移いたしました。

全社を挙げての積極的な営業活動と生産活動に対応した結果、連結売上高は426.3億円(前期比12.0%増)と

なりました。しかしながら原材料の高騰などによる材料費や減価償却費、人件費が増加したことから、営業利益は52.2億円(前期比12.6%減)、売上高営業利益率は12.3%となりました。当期純利益は32.4億円(前期比20.4%減)、ROEは7.5%となりました。

設備投資額につきましては、各務原工場、各務東町工場の増産設備28.8億円、研究開発センターの検査装置に6.4億円、米国子会社の倉庫設備などに7.7億円など、総額56.9億円の設備投資を行いました。

# 特集 新社長に聞く



## 私が考える フジミの成長戦略

本年4月1日より代表取締役社長を拝命いたしました関 敬史です。これまではCMP事業本部長として経営の一翼を担ってまいりましたが、今後はフジミインコーポレーテッドおよびフジミグループ全体をけん引するリーダーとして、10年先、20年先を見据えたフジミグループの持続的な成長を目指してまいります。

昨年、当社はジャスダックから東証一部・名証一部に市場を変え、新たなステージでのスタートを切りました。今後はグローバル化の進展に加えて、当社を取り巻く経営環境も刻一刻と変化していきます。スピード感をもった経営を心がけながら、株主の皆様のご期待にお応えしたいと考えております。

代表取締役社長 関 敬史

### 関 敬史(せき・けいし)の略歴

昭和39年新潟県生まれ。平成元年慶応大学法学部を卒業後、(株)富士銀行に入行、平成9年同行を退職し、当社に入社。平成12年米国の子会社旧フジミコーポレーションに社長として出向。平成15年取締役新規事業本部長兼CMP事業部長。平成17年取締役CMP事業本部長。平成20年4月に代表取締役社長に就任。好きな言葉は「ベストを尽くす」。

## ベストを尽くします

### 就任にあたって

— 就任から約3カ月が経過しましたが、今の率直なお気持ちを聞かせてください。

**関** 最初に話をもらった時、大変なことになったなあ、というのが正直な気持ちでした。前社長からは、何度かそのような話をそれとなく言われていたものの、この時期というのは全く想定していませんでした。

— 大きく変わった点はありますか。

**関** お目にかかる方々が増えたことでしょうか。経営トップとなると、金融関係や地域の経済界の方々も含まれますから、予定表が埋まるのが早くなりました。

— 越山前社長からのミッションはどのようなものでしたか。

**関** ご一緒する機会は頻繁にありましたから、前社長が何を考え、何をしなければいけないかということでは、二人の思いがかけ離れていることはありません。思う存分やらせていただこうと思っています。そして引き受けたからには、ベストを尽くします。

## 米国の子会社社長を経て、CMPという新分野を軌道に

### これまで経験したこと

— ご経歴やご経験を簡単にご紹介ください。

**関** 職歴からお話しますと、1989年(平成元年)に富士銀行に入行し、東京・日比谷支店に3年

半勤めました。日比谷支店というのは、外資系の日本法人との取引も多いことから外為渉外の窓口を担当しました。その後、ロンドン支店に移り、ストラクチャード・ファイナンス業務を行いました。富士銀行に8年間勤めた後、フジミに入社し、米国の販売子会社フジミコーポレーションの日本側の営業窓口を担当しました。

— 当時のフジミコーポレーションは？

**関** フジミコーポレーションは、1984年(昭和59年)に当社と現地会社の50対50の合併販売会社としてスタートしました。取扱商品の100%は当社の製品でしたから、そろそろ100%の子会社にしようという話があり、私が買収に向けた交渉の窓口となりました。交渉がまとまって完全子会社化できたのが1999年。翌年から1年だけ私が社長に就き、その後、現社長(長岡正幸)にバトンタッチしました。



米国の子会社フジミコーポレーション時代の関 敬史(右側)

— その後、CMP事業本部長となられるわけですね。

**関** 1995年(平成7年)CMP向け研磨材は、開発に着手していました。アメリカを中心にCMPと

いう新しい分野が立ち上がっていると分かっていたからです。私が担当したのは2001年(平成13年)からですが、1998年(平成10年)から3年ほどで急拡大しました。私が初めて担当した年の売上が20億円、現在は連結ベースで100億円までになりました。私が担当した当時は、フジミといえば、シリコンウェハー向けやハードディスク向けのスラリーメーカーとしての知名度はありましたがCMPの分野では全くの無名でしたから、お客様に会っていただくのもひと苦労という状況でした。

— ライバル企業との差別化は？

**関** この分野は1社の独占に近い状況でした。1社の独占では、いざというときのリスクがありますから、2社購買を導入したい、というのがお客様のニーズでした。2001年に完成した当社の研究開発センターにおいて、お客様の製造工程と同じ環境下で研究開発ができるようになったことが、当社の強みにもなっています。

## 日本初の人造研磨材メーカーの誇りを胸に

### 「フジミ」ってどんな会社？

— 新社長は社外の皆様にフジミをどのように紹介されていますか。

**関** フジミは日本で最初の人造研磨材メーカーとして1950年(昭和25年)に創業しました。創業者の越山照次は、戦時中から光学レンズ向けの研磨材を研究してきましたが、戦後もまもなく双眼鏡、カメラ、プリズム、照準鏡などのレンズ



20周年記念式典(昭和45年10月)であいさつする創業者・越山照次

を磨く研磨材の需要が拡大し、当社の前身である「不二見研磨材工業株式会社」を立ち上げました。1957年(昭和32年)になって、東京通信工業(現ソニー)からある製品を磨きたいとの要望が寄せられました。それはのちのトランジスタの基板になるゲルマニウムでした。結果として、フジミの研磨材で磨いたゲルマニウムが、大量のトランジスタラジオを生み出しました。この出来事が当社を半導体関連の研磨材分野に進出させるきっかけとなりました。今では、半導体デバイス向けシリコンウェハー用が約4割、CMP用が約3割、ハードディスク用が約1割、その他が約2割となっています。

## 何もしないと、何も生まれない

### 事業の現状をいかに捉えるか

— 主要な事業ごとの課題をどのように捉えていますか。まず、シリコンウェハー用から…。

**関** 半導体部品の土台となる基板がいわゆるシリコンウェハーですが、それらの表面を磨く研磨

**スラリー：**  
粉体と液体を混合した研磨材。砥粒(粉体)によるメカニカルな研磨と研磨促進効果をもつ添加剤(液体)の作用を有する。

**不二見研磨材工業株式会社：**  
国産初の人造精密研磨材メーカー。1991年(平成3年)にフジミコーポレーションと改称。

**ゲルマニウム：**  
それまでの真空管に替わって初期のトランジスタラジオの部品として使用された。

**半導体デバイス：**  
IC(集積回路)、トランジスタ、ダイオードなどの半導体電子回路部品の総称。

材製造が1960年代から当社の中核事業となりました。家族に例えるなら、フジミにおける屋台骨、お父さんといってよいでしょう。すでに子供たちは高校生や大学生になってひと安心という状況かもしれませんが、本人はまだまだ現役です。30年近く競争の渦中にいた経験からいえば、品質と価格面の競争は今後も続くと思います。

— 事業責任者であったCMP用はいかがでしょうか。

関 子供たちの中ではもっとも金と手間がかかった息子です。私立中学から私立高校、そして大学に入りました。ようやく大学を卒業し、ひとり立ちをし、両親に学費、家賃を返し始め、恩返しをしているところでしょうか。

— ハードディスク用はいかがでしょうか。

関 小学生から飛び級で高校生になった早熟で優秀な子供です。この分野の技術の進歩があまりに目覚ましく、1枚のディスクの記憶容量は毎年倍々で進みました。そのため、ハードディスクの研磨の枚数が減って、ディスクの小口径化も進んで研磨材の使用量も少なくなっています。

CMPのように今後2ケタ伸びるということではないですが、今あるシェアを少しでも拡大することが大切です。製品の寿命もどんどん短くなっており、開発と営業の距離感を短くし、スピードをもった顧客対応をと考えています。

#### 溶射材：

高温で溶融したセラミックスや金属微粉を塗布し、対象物の表面を改質する表面加工材。建機、航空機、鉄鋼、自動車機械部品など長寿命が求められる素材に用いられ、最近では、半導体製造装置にも使われている。

#### 日本版-SOX法：

会計不祥事や法令遵守の欠如などを防止するため、米国のサーベンス・オクスリー法を模して整備された日本の法規制。2009年3月期の本決算から適用となる。



— 溶射材などその他の事業はいかがですか。

関 溶射材はこの数年で売上が10倍になりました。ようやく大学に入ったくらいですが、事業としては、黒字を出すようになり、将来のポテンシャルも期待されています。当社にとっては大切に育てていきたい分野です。

— 新規事業についてのお考えをお聞かせください。

関 インターオプテックとの資本・業務提携は、新規事業として新素材基板の加工技術への参入を図ったものですが、短期間での収益改善が見込めないと判断し前期決算で特別損失を計上しました。新事業のハードルをどのようにクリアしていくか、良い勉強の機会であると思っています。10年先、20年先をにらんだ新しい事業の育成は、私のミッションの一つです。体力がある今だからこそ、新しい投資を行い、持続的な成長を確実なものにしたいと思っています。何もしないと、何も生まれないわけですから……。

## 社会の変化に合わせて 機敏に対応する組織を

### 組織変更と新人事体制

— 4月1日付けで組織と人事が変わりました。そこに込められた狙いはどのようなものでしょう。

関 いくつか新しい試みをスタートしています。まず、「管理本部」を「財務管理本部」と改称しました。これには2つ狙いがあります。1つは一部上場を踏まえ、今後は日本版-SOX法の適用を前提に内部統制の機能を整えること、もう



1つは迅速な四半期開示に注力する体制を整えることです。そして、「管理本部」から「総務・人事」の機能を分割し「総務室」と改称して私の直轄にしました。また、「経営企画室」から「戦略事業課」を独立させ、営業本部の下に「営業開発部」を設けました。新しい事業を日々の営業活動とより密接なものにしたいという思いです。

— 就任にあたって3つのキーワードを掲げていますね。

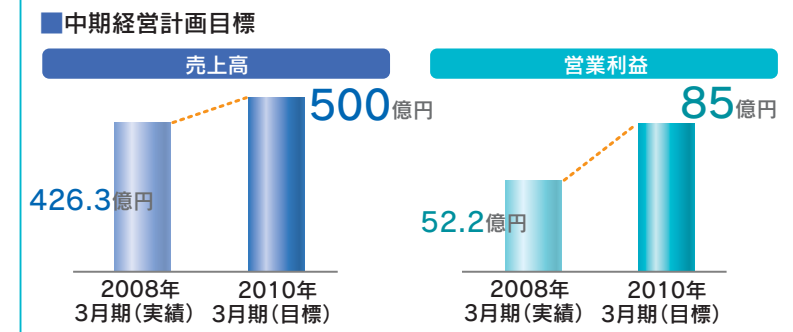
関 就任の際に「つよく、やさしく、おもしろい」会社の実現と10年後、20年後も持続できる安定成長に向けて、3つのキーワードを発表しました。①圧倒的な開発力 ②品質 ③人材育成です。実はこの3つは関連しています。開発力も品質も人が鍵になります。また、開発力を生かすも殺すも品質次第です。いかに品質を保証していけるか、ここに開発力を生かす道があります。人材育成では、開発・品質保証・製造・営業の連携が重要です。互いの力を機動的に発揮することができれば、フジミはまだまだ強くなります。常に時間軸を意識し、スピード感をもって取り組みたいと思います。

## 目標達成に向けて

### 中期経営計画と今後の成長戦略

— 2010年3月期を最終年度とする「中期経営計画」に、どのように対応されますか。

関 2年前の2006年に策定した計画では2010年の3月期までに売上高500億円、営業利益を85億円にするという目標ですが、売上目標については達成できると考えています。ただ、営業利益については世界的な原材料高騰の影響により、ハードルはかなり高くなっています。この1年で主原材料が10~20%値上がりしています。原材料の高騰分をお客様に少しでもご協力いただくとともに、自社内でもコスト削減策を図らなければなりません。



— 株主様に一言いただけますか。

関 引き続き、中期経営計画の達成に向けて精一杯努力いたします。さらには10年後、20年後を見据えて、成長を安定的に持続できるような全社の仕組みづくりを進めます。株主の皆様の変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。

中期経営計画：2010年3月期を最終年度とする経営計画。売上高500億円、営業利益85億円を達成するため、事業部門別の目標を明らかにしている。

# フジミの事業とセグメント情報

## シリコンウェハー用

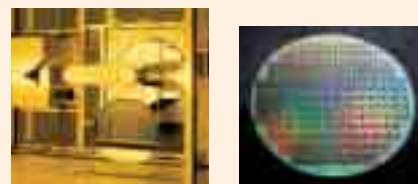
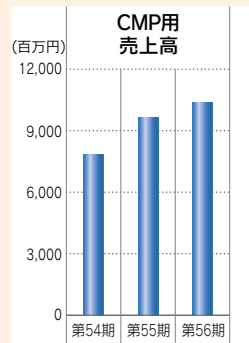
パソコンを中心に、OA機器やAV製品など、電子・IT関連機器の心臓部に使用されている半導体部品の土台がシリコンウェハー（半導体基板）です。このウェハーをいかに高精度に鏡面研磨できるかが、エレクトロニクス製品の性能を大きく左右します。半導体デバイス向け300ミリウェハーの世界的需要の高まりと、顧客の高品質化のニーズにより、ラッピング材の売上高は前期比17.7%増となりました。また、ポリシング材の売上高は同19.4%増となり、シリコンウェハー用全体の売上高は171.3億円、同18.9%増となりました。



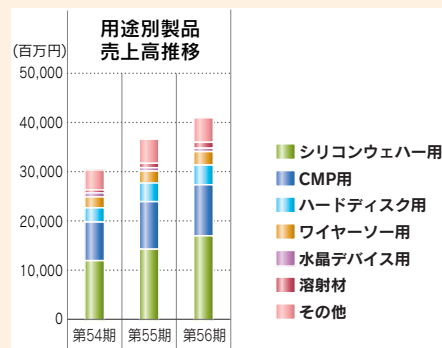
半導体の基板であるシリコンウェハー。現在の主流は、直径300mmの大口徑となり、表面を高精度に磨き上げるために当社の超精密研磨材が使われています。

## CMP用

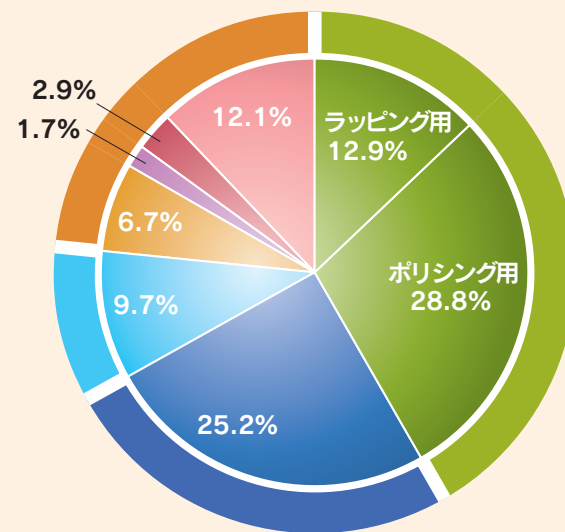
CMP（化学的機械的平坦化）用は、長年にわたるシリコンウェハー用ファイナルポリシング材のノウハウを応用して開発された製品群です。エレクトロニクス製品の小型化とともに高機能化・高性能化が急速に進み、半導体チップはますます高集積化・微細化が求められています。多層配線技術に使用されるCMP用は、今後も引き続き高成長が期待される分野です。PLANERLITEシリーズは、その優れた品質特性からメモリー向け製品をはじめとして国内外のデバイスメーカーへの出荷が堅調に推移し、売上高は103.7億円、同7.4%増と増加しました。



様々な情報通信機器やエレクトロニクス製品の技術進展が加速する中、半導体チップはますます小さく、その配線は細くなっています。肉眼では見えない細かな配線は今では10~12層にも積み上げられ、その製造過程において、CMP研磨は欠かせないことができます。

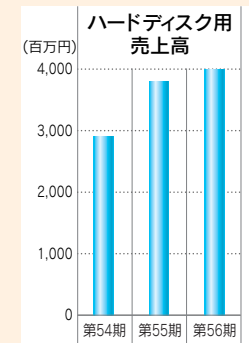


※グラフは商品を含めない自社製品のみでの売上高です。



## ハードディスク用

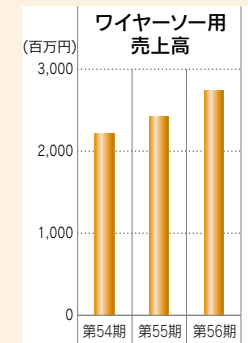
パソコンの高機能化に伴い、プログラムやデータの高速読み出しが可能な小型・大容量のハードディスクの需要が高まり、ディスクの表面研磨は、シリコンウェハーと同等級以上の面精度が要求されています。ハードディスク市場は、ノートパソコンの好調な販売によりパソコン全体の出荷台数が2桁程度の増加を示し、また、HDD搭載型DVDレコーダーや携帯音楽端末の普及が進みました。アルミディスク用は市場再編による在庫調整が見られたものの、高記憶容量ニーズに支えられ増加しました。小口径のガラスディスク用については、従来の長手記録方式から垂直磁気記録方式への転換による在庫調整やフラッシュメモリへの移行による影響を受けたものの、ハードディスク用全体の売上高は40.0億円、同5.5%増となりました。



写真や映像を手軽に加工したいという市場ニーズが高まり、技術革新が進んだことで、パソコン、デジタルカメラ、携帯電話などのデジタル家電は、より多くの情報が記憶できるようになりました。それに伴い、記憶装置であるハードディスクの研磨面にも今まで以上の高いレベルが求められています。

## ワイヤーソー用、水晶デバイス用、溶射材、その他の用途

単結晶のシリコンインゴット（塊）から厚さ1ミリ未満のウェハーに切断するため使用されるワイヤーソー用砥粒。これは太陽電池切断向けにも使われています。半導体デバイス向け300ミリウェハーの世界的需要の高まりもあり、売上高は27.3億円、前期比12.8%増となりました。水晶デバイス用は、部品の小型化・薄型化、中国製研磨材との競合激化などの影響を受けたものの、その主用途である携帯電話の世界的な市場拡大などにより、売上高は6.9億円、同2.3%と微増しました。溶射材は高機能皮膜が形成可能であることから、建設機械部品や鉄鋼分野の各種ロール、航空機エンジンや船のスクリューなどの耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性などを高める用途に使われており、積極的な営業活動と技術支援活動を行ったことにより、売上高は11.9億円、同33.2%増となりました。



シリコンや太陽光発電用のセルの切断、携帯電話・デジタルカメラなどでスイッチや周波数制御をする水晶部品の研磨・切断にも当社製品が使われています。溶射材は様々な機械部品の耐久性を高める皮膜として注目されています。

# 連結財務諸表

(単位：百万円)

連結損益計算書	第55期 平成18年4月1日から 平成19年3月31日まで	第56期 平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで
<b>売上高</b>	38,060	<b>42,630</b>
売上原価	24,974	<b>29,429</b>
販売費及び一般管理費	7,106	<b>7,975</b>
<b>営業利益</b>	5,979	<b>5,226</b>
営業外収益	184	<b>181</b>
受取利息/配当金	83	<b>106</b>
その他	101	<b>74</b>
営業外費用	41	<b>118</b>
支払利息	10	<b>49</b>
その他	30	<b>68</b>
<b>経常利益</b>	6,122	<b>5,289</b>
特別利益	504	<b>96</b>
特別損失	55	<b>388</b>
<b>税金等調整前当期純利益</b>	6,572	<b>4,997</b>
法人税、住民税及び事業税	2,518	<b>1,934</b>
法人税等調整額	△30	<b>△224</b>
少数株主利益	3	<b>37</b>
<b>当期純利益</b>	4,080	<b>3,249</b>

## 売上高

総売上高は426.3億円(前期比12.0%増)となりました。ラッピング材およびポリシング材は堅調なシリコンウェハー市場の拡大、顧客の高品質化のニーズから好調に推移しました。半導体の高集積化・微細化に伴う多層配線技術に使用されるCMP向け製品は、一時的な在庫調整局面はあったものの、引き続き堅調に推移しました。ハードディスク向け製品は、若干の在庫調整が見られたものの、パソコンや家電製品への搭載を背景とした高記憶容量化ニーズに支えられ増加いたしました。

## 営業利益

売上高は増加しましたが、原材料の高騰や減価償却費および人件費が増加したことなどから、営業利益は52.2億円(前期比12.6%減)となりました。

## 当期純利益

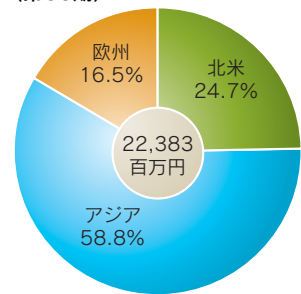
当社の連結子会社となる株式会社インターオプテックに関して減損損失2.8億円を特別損失として計上いたしました。その結果、当連結会計年度における純利益は32.4億円(前期比20.4%減)となりました。

## 海外売上高

(単位：百万円)

	第55期	第56期
海外売上高 (連結売上高)	19,122 (38,060)	<b>22,383 (42,630)</b>
連結売上高に 占める割合	50.2%	<b>52.5%</b>

## 海外売上高構成比 (第56期)



\* 各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりです。

北米：米国、カナダ  
アジア：台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国  
欧州：英国、デンマーク、ドイツなど

(単位：百万円)

連結貸借対照表	第55期 平成19年3月31日現在	第56期 平成20年3月31日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産	32,202	<b>30,747</b>
現金及び預金	10,710	<b>6,307</b>
受取手形及び売掛金	12,781	<b>12,195</b>
たな卸資産	6,151	<b>7,742</b>
その他	2,601	<b>4,515</b>
(貸倒引当金)	△42	△12
固定資産	21,528	<b>24,485</b>
有形固定資産	18,230	<b>20,456</b>
無形固定資産	324	<b>425</b>
投資その他の資産	2,972	<b>3,604</b>
資産合計	53,730	<b>55,233</b>

(単位：百万円)

	第55期 平成19年3月31日現在	第56期 平成20年3月31日現在
<b>負債の部</b>		
流動負債	10,990	<b>10,154</b>
支払手形及び買掛金	5,373	<b>5,185</b>
短期借入金	340	<b>720</b>
その他	5,276	<b>4,247</b>
固定負債	102	<b>543</b>
負債合計	11,092	<b>10,697</b>
<b>純資産の部</b>		
株主資本	41,738	<b>43,818</b>
資本金	4,753	<b>4,753</b>
資本剰余金	5,062	<b>5,070</b>
利益剰余金	33,368	<b>35,344</b>
自己株式	△1,445	△1,349
評価・換算差額等	757	<b>522</b>
新株予約権	—	<b>11</b>
少数株主持分	143	<b>183</b>
純資産合計	42,638	<b>44,536</b>
負債純資産合計	53,730	<b>55,233</b>

(単位：百万円)

連結株主資本等変動計算書 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)	株主資本				評価・換算差額等		新株予約権	少数株主持分	純資産合計	
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金				為替換算 調整勘定
<b>平成19年3月31日残高</b>	4,753	5,062	33,368	△1,445	41,738	210	546	—	143	42,638
<b>連結会計年度中の変動額</b>										
剰余金の配当			△1,273		△1,273					△1,273
当期純利益			3,249		3,249					3,249
自己株式の取得				△1	△1					△1
自己株式の処分		7		97	105					105
株主資本以外の項目(純額)						△130	△104	11	40	△182
<b>連結会計年度中の変動額合計</b>	—	7	1,976	96	2,080	△130	△104	11	40	1,898
<b>平成20年3月31日残高</b>	4,753	5,070	35,344	△1,349	43,818	80	442	11	183	44,536

(単位：百万円)

連結キャッシュ・フロー計算書	第55期	第56期
	平成18年4月1日から 平成19年3月31日まで	平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	2,990	<b>4,613</b>
税金等調整前当期純利益	6,572	<b>4,997</b>
減価償却費	2,013	<b>2,899</b>
有形固定資産売却益	△446	△1
売上債権増減額	△2,602	<b>538</b>
仕入債務増減額	930	△149
たな卸資産増減額	△1,327	△1,676
その他	△70	<b>249</b>
小計	5,070	<b>6,856</b>
利息及び配当金の受取額	77	<b>104</b>
新規産業補助金収入	49	<b>23</b>
法人税等の支払額	△2,196	△2,325
その他	△10	△45
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△3,182	△6,371
定期預金の預入による支出	△1,000	△500
有価証券の取得による支出	—	△99
有価証券の売却による収入	1,000	—
投資有価証券の取得による支出	△2	△3
有形固定資産取得による支出	△3,758	△6,046
その他	579	277
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	△936	△321
短期借入金の純増加(減少)額	△17	288
長期借入金の純増加(減少)額	△1	558
自己株式の取得及び売却による収支	201	104
配当金の支払額	△1,119	△1,273
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	113	23
<b>現金及び現金同等物の増加(減少)額</b>	△1,015	△2,055
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加	205	—
<b>現金及び現金同等物期首残高</b>	12,595	<b>11,785</b>
<b>現金及び現金同等物期末残高</b>	11,785	<b>9,729</b>

**営業活動によるキャッシュ・フロー**

営業活動の結果得られた資金は46.1億円(前期比54.4%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が49.9億円(前期比24.0%減)と減少し、たな卸資産が16.7億円(前期比26.3%増)増加し、法人税等の支払額が23.2億円(前期比5.9%増)とそれぞれ増加したものの、減価償却費が28.9億円(前期比44.0%増)と大幅に増加し、売上債権増減額が当期は減少(前期は増加)したことによるものです。

**投資活動によるキャッシュ・フロー**

投資活動の結果使用した資金は、63.7億円(前期比100.3%増)となりました。これは主に、有形固定資産取得による支出60.4億円(前期比60.9%増)によるものです。

**財務活動によるキャッシュ・フロー**

財務活動の結果使用した資金は3.2億円(前期比65.6%減)となりました。これは主に、配当金の支払額が12.7億円(前期比13.7%増)増加したものの、短期借入金の純増加額2.8億円および長期借入金の純増加額5.5億円があったことによるものです。

**個別決算の概要**

(単位：百万円)

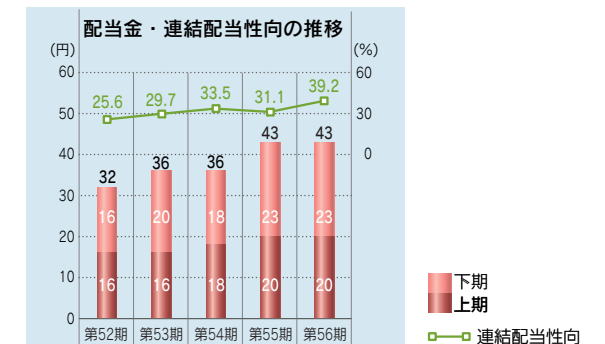
損益計算書	第55期	第56期
	平成18年4月1日から 平成19年3月31日まで	平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで
<b>売上高</b>	32,140	<b>35,349</b>
売上原価	21,584	<b>24,608</b>
販売費及び一般管理費	5,642	<b>6,250</b>
<b>営業利益</b>	4,913	<b>4,491</b>
営業外収益	293	<b>349</b>
営業外費用	28	<b>118</b>
<b>経常利益</b>	5,178	<b>4,722</b>
特別損益	△5	△1,007
<b>税引前当期純利益</b>	5,173	<b>3,715</b>
法人税、住民税及び事業税	1,902	<b>1,587</b>
法人税等調整額	△3	△501
<b>当期純利益</b>	3,274	<b>2,630</b>

**配当金および連結配当性向の推移**

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と位置付け、業績に応じた積極的な株主還元を行うべく30%以上の連結配当性向を目標として経営にあたってまいりました。また、内部留保につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、これまで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える開発・生産体制を強化し、グローバルな事業戦略を遂行するために役立てる所存です。その結果、当期末配当につきましては、前期と同じ1株につき23円とし、年間で43円といたしました。

(単位：百万円)

貸借対照表	第55期	第56期
	平成19年3月31日現在	平成20年3月31日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産	27,324	<b>25,035</b>
固定資産	22,327	<b>25,231</b>
資産合計	49,652	<b>50,267</b>
<b>負債・純資産の部</b>		
流動負債	9,838	<b>8,468</b>
固定負債	89	<b>733</b>
負債合計	9,927	<b>9,201</b>
資本金	4,753	<b>4,753</b>
資本剰余金	5,062	<b>5,070</b>
利益剰余金	31,143	<b>32,500</b>
自己株式	△1,445	△1,349
その他有価証券評価差額金	210	<b>80</b>
新株予約権	—	<b>11</b>
純資産合計	39,724	<b>41,066</b>
負債及び純資産合計	49,652	<b>50,267</b>



## 01 各務原工場第5棟 & 新管理棟竣工

各務原工場第5棟は、300mmウェハーなどの大口径化や微細化で需要が伸びる高品質のシリコンウェハー用ラッピング材の増産に対応するために、大掛かりな工事となりました。同時に建設していた新管理棟も完成し、先に竣工した各務東町工場第2棟と合わせ、ますます需要が高まる市場からのニーズにお応えする体制が整いました。



## 02 個人投資家と海外の機関投資家に当社を紹介

12月5日、東京・日本橋のマングリンオリエンタル東京ホテルにおいて野村インベストメントフォーラムが開催されました。世界の主要マーケットに拠点を置く、海外の機関投資家40社に対して、越山前社長がプレゼンテーションと質疑応答をあわせて60分行いました。また、12月21日・22日の両日、名古屋国際会議場において野村証券主催の「東海三県ノムラ資産管理フェア2007」では、個人投資家向けに当社への理解を深めていただくための説明を行いました。当社ブースには700名を超える方々が訪れ、最近の研磨材市況の動きなどに関心を示されました。



## 03 SiC基板の加工技術でNEDOと共同研究を開始

当社のSiC(シリコンカーバイド:炭化珪素)基板加工技術の開発テーマが、独立行政法人「新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)」の「エネルギー使用合理化技術実用化開発共同事業」に採択されました。SiC基板はSi(シリコン)基板に比べ、使用電力が少なく、高温や放射線、耐薬品環境などに優れているため、現在の主流であるSi(シリコン)基板の次世代の半導体基板として期待されています。研究開発費2億5千万円の3分の2をNEDOからの補助として受けることになりました。

## 04 セミコン・ジャパン2007に出展

12月5日～7日の3日間、千葉県・幕張メッセで開催された半導体業界最大のイベントである「セミコン・ジャパン2007」に出展しました。今回は、世界各国より約1,600社が参加し、出展者数・展示スペースとも過去最大規模となりました。半導体製造技術の将来展望を踏まえ、既存のお客様はもちろん新規先の掘り起こしに、役員・社員が一丸となって対応しました。



## 株式情報 2008年(平成20年)3月31日現在

### 株式の状況

株式数	発行可能株式総数	120,000千株
	発行済株式総数	30,699千株
	株主数	7,409名

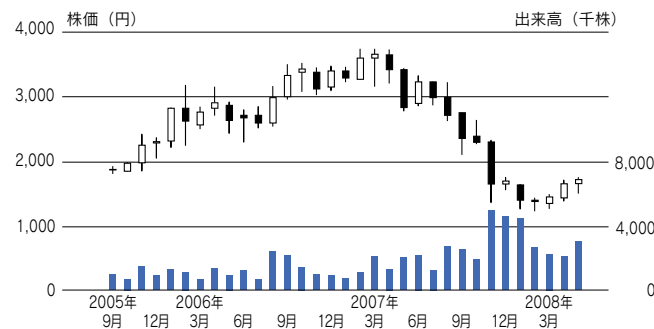
### 大株主

株主名	持株数	持株比率
越山 勇	3,102千株	10.1%
野田 純孝	2,520	8.2
有限会社コマ	1,638	5.3
日本スタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,558	5.1
越山 彰	1,151	3.8
株式会社フジインコーポレーテッド(自己株口)	1,027	3.3
資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口)	1,021	3.3
株式会社三菱東京UFJ銀行	971	3.2
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	925	3.0
日本生命保険相互会社	779	2.5

## 役員 2008年(平成20年)6月24日現在

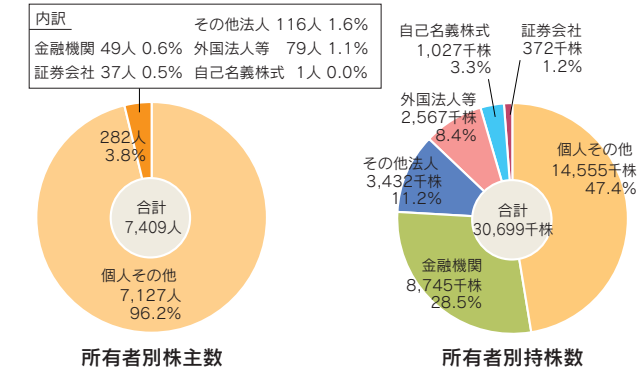
代表取締役会長	越山 彰
代表取締役社長	関 敬史
取締役	児玉 一志
取締役	松島 伸男
取締役	土屋太加志
常勤監査役	藤本 俊之
常勤監査役	久保 昌昭
監査役	鮎澤 多俊
監査役	山下 紀雄

## 株価および出来高の推移



\* 株価データは、株式分割を過年度に遡り調整した修正株価を使用しています。

## 株主分布状況 2008年(平成20年)3月31日現在



所有者別株主数

所有者別持株数